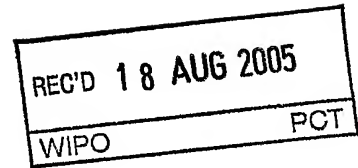


特許協力条約

PCT



特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第 12 条、法施行規則第 56 条）

〔PCT36 条及びPCT規則 70〕

出願人又は代理人 の書類記号 TU04-1109W01	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 4 / 0 1 7 7 4 4	国際出願日 (日. 月. 年) 3 0 . 1 1 . 2 0 0 4	優先日 (日. 月. 年) 2 5 . 1 2 . 2 0 0 3
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. ⁷ C23C14/34, C22C9/00, 9/06		
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 日鉱マテリアルズ		

<p>1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の規定に従い送付する。</p> <p>2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。</p> <p>3. この報告には次の附属物件も添付されている。</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> 附属書類は全部で 1 ページである。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)</p> <p><input type="checkbox"/> 第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙</p> <p>b. <input type="checkbox"/> 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照)</p>	
<p>4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎</p> <p><input type="checkbox"/> 第 II 欄 優先権</p> <p><input type="checkbox"/> 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成</p> <p><input type="checkbox"/> 第 IV 欄 発明の単一性の欠如</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 第 V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明</p> <p><input type="checkbox"/> 第 VI 欄 ある種の引用文献</p> <p><input type="checkbox"/> 第 VII 欄 国際出願の不備</p> <p><input type="checkbox"/> 第 VIII 欄 国際出願に対する意見</p>	

国際予備審査の請求書を受理した日 1 0 . 0 5 . 2 0 0 5	国際予備審査報告を作成した日 0 1 . 0 8 . 2 0 0 5	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 真々田 忠博	4 G 8 2 1 6
電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 1 6		

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____ 語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査
☐ PCT規則12.4にいう国際公開
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第 1-10 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第 2, 4-6 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 1 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 _____ 項*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ 項*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☒ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ

☒ 請求の範囲 第 3 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること) _____

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること) _____

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1, 2, 4-6	有
	請求の範囲		無
進歩性(IS)	請求の範囲	1, 2, 4-6	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1, 2, 4-6	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: YUTAKA KOSHIBA, et al., Mitsubishi materials' high performance oxygen free copper and high performance alloys, SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROCESSING MATERIALS FOR PROPERTIES, 2000, p101-104

文献2: JP 03-079734 A(住友金属鉱山伸銅販売株式会社) 1991.04.04,
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

文献3: JP 01-180975 A(田中貴金属工業株式会社) 1989.07.18,
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

文献4: JP 11-236665 A(株式会社ジャパンエナジー) 1999.08.31,
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

文献5: JP 2001-329362 A(株式会社日鉱マテリアルズ) 2001.11.27,
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

請求の範囲 1, 2, 4-6

請求の範囲 1, 2, 4-6 に記載された発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも記載されておらず、新規性及び進歩性を有する。Be:0.2~0.5wt%、を含有する低ベリリウム銅合金からなるバックングプレート、又は、Ni:2~4wt%、Si:0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si合金からなるバックングプレート、若しくは、Ni:2~4wt%、Si:0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金からなるバックングプレートを用いる点は、当業者といえども容易には想到し得ないことである。

請求の範囲

- [1] (補正後) マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体であって、銅合金バックングプレートがBc: 0.2~0.5wt%含有する低ベリリウム銅合金又はNi: 2~4wt%, Si 0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si合金若しくはNi: 2~4wt%, Si 0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体。
- [2] Cu-Ni-Si系合金バックングプレートにおいて、Ni: 2~4wt%, Si 0.3~0.9wt%, Cr: 0.1~0.9wt%若しくはMg: 0.1~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする請求項1記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体。
- [3] (削除)
- [4] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体であって、銅合金バックングプレートが導電率35~60% (IACS)、0.2%耐力400~850MPaを備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体。
- [5] 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体。
- [6] 拡散接合温度が175~450°Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バックングプレート組立体。